

★特徴

- ・ **1.5～14W/m・K**のまで用途に合わせたラインナップ
- ・ **100W/m・K**も近日公開予定



TIM (Thermal Interface Material) 材は、電子デバイスやパワーモジュールから発生する熱を効率的に放熱し、装置全体の信頼性と性能を向上させるために開発された高熱伝導インターフェース材料です。デバイスとヒートシンク（放熱板）とのわずかな隙間を埋め、熱抵抗を最小化することで、高出力化・高密度実装化が進む電子機器の熱設計に不可欠な役割を果たします。

★主な用途

- ・ パワーモジュール（SiC・GaN対応）用放熱界面材
- ・ CPU、GPU、ASICなど高発熱デバイスの放熱材料
- ・ LED照明、通信基地局、車載インバータ
- ・ 5G/EV/AIサーバー機器の熱制御部材
- ・ バッテリーパック・電源制御ユニット

★効果・利点

TIM材の採用により、デバイスとヒートシンク間の熱伝達効率を最大化し、動作温度上昇を抑制、性能安定化と寿命延長を実現。また、表面改質フィラーや低アウトガス樹脂を用いることで、高信頼性・低汚染性を確保し、車載・宇宙・産業用途など高い品質要求にも対応します。